

烟台德邦科技股份有限公司

关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为积极响应上交所沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动工作要求，严格落实公司《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》部署，2026 年上半年，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）专注于高端电子封装材料研发与产业化，紧扣行业发展机遇，以高质量发展为主线，围绕经营策略优化、内部治理升级、股东回报机制完善、投资价值提升等维度深耕发力。公司持续夯实精细化运营管理体系，稳步提升经营发展质效，对照专项行动工作部署，常态化开展阶段性复盘与成效评估。

报告期内，公司结合当期经营成果、市场环境及行业发展趋势，动态优化经营策略与股东回报保障措施，补齐发展短板，取得阶段性成效。依托专项行动深入推进，公司核心经营竞争力持续增强，高质量发展动能持续蓄积，企业内在价值与资本市场投资价值稳步提升。现将公司 2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动实施情况及成效汇报如下。

一、聚力主业经营，提质稳健发展

报告期内，公司坚守电子封装材料核心主业，聚焦集成电路封装、智能终端封装、新能源应用、高端装备应用四大核心赛道，持续完善从零级至三级不同级别的电子封装产品体系，匹配不同层级客户的多元化、高品质需求，深化与行业头部标杆企业的战略合作，筑牢主业发展基本盘。同时，公司结合各细分市场发展趋势与需求差异，推行精细化、差异化经营策略，持续优化产品结构、提升市场渗透率与核心竞争力，在行业竞争中稳步夯实发展优势、把握产业发展机遇，实现主业经营质量与发展效益同步提升。各核心业务领域半年度经营发展情况具体如下：

（一）把握先进封装发展机遇，持续推进封装材料业务布局

报告期内，集成电路封装行业整体保持稳健发展态势，AI 算力芯片、HBM 技术持续迭代，带动先进封装市场需求稳步释放，下游封测企业有序扩产，为封

装材料行业带来持续的市场发展空间。公司紧抓行业发展机遇，立足自身技术与产品优势，持续迭代优化产品体系，完善集成电路封装材料多品类战略布局，进一步提升产业链配套能力。

目前公司集成电路封装核心产品布局持续完善，主要涵盖晶圆 UV 膜系列、固晶材料系列、导热界面材料、芯片级底部填充胶、Lid 框粘接 AD 胶等多款产品。其中，晶圆 UV 膜、固晶胶、TIM1.5/TIM2 导热界面材料等成熟品类，已稳定配套国内主流封测厂商，批量供货秩序良好，国产化配套优势稳步夯实，其中，高性能导热硅脂、导热凝胶、高导热凝胶垫片、相变材料及液态金属等高端导热界面材料，已批量应用于数据中心（AI 服务器/GPU）、新能源汽车（电池/BMS/电控）、消费电子等领域。同时，公司持续推进高端新材料产业化落地，DAF/CDAF 膜、底部填充胶、Lid 框胶等产品已实现小批量交付；TIM1 材料已顺利通过国内重点封测客户全套可靠性验证，先进封装材料商业化应用进程稳步推进。

（二）智能终端封装业务稳步深耕，市场格局持续优化

报告期内，端侧 AI 应用普及、可穿戴设备场景落地、智能显示技术升级，持续带动智能终端行业稳步发展，为上游封装材料产业提供良好的发展环境。公司聚焦终端客户核心应用需求，持续深耕细分领域，优化产品方案、拓展应用场景，持续提升市场综合竞争力。

公司智能终端封装材料产品体系适配性广泛，可覆盖智能手机、TWS 耳机、智能手表、平板、笔记本电脑、车载电子、平板显示等主流终端产品，已实现对苹果、华为、小米、OPPO、vivo、传音等国内外头部终端品牌的稳定批量供货，客户合作根基扎实。细分领域方面，TWS 耳机领域，公司紧跟终端产品迭代节奏，持续优化配套材料解决方案，稳固头部客户供应链份额；车载电子领域，多品类封装材料稳步实现批量导入，覆盖车载显示模组、智能座舱、域控制器等核心场景，业务规模稳步放量；智能屏显领域，伴随 LIP0 窄边框屏幕封装工艺持续渗透，公司配套研发的立体屏幕封装光敏树脂材料已实现规模化稳定供货，贴合行业技术升级趋势。

与此同时，公司持续挖掘新兴市场机遇，在优化现有产品性能、升级生产工艺的基础上，积极布局 AR 智能眼镜等新型智能终端领域，有序开展产品验证与资质认证工作，稳步拓宽业务增长空间。

（三）新能源封装业务稳健增长，产业布局持续完善

报告期内，动力电池市场平稳增长，储能电池行业需求持续释放，消费锂电市场稳步回暖，新能源材料行业整体发展态势向好。公司把握行业发展机遇，通过完善产品矩阵、优化产能布局、迭代核心技术，推动新能源应用材料业务稳健增长，持续提升行业竞争优势。

产品层面，公司构建了多元化新能源封装材料体系，包含聚氨酯导热结构胶、多元杂化胶、改性硅烷密封胶、轻量化灌封胶、UV 绝缘涂层等系列产品，可适配方形、圆柱、软包全品类电芯，充分满足新能源电池 PACK 多场景封装应用需求。同时，公司坚持前瞻技术布局，持续开展固态电池配套新材料研发迭代，稳步构筑长期技术竞争壁垒。产能层面，公司依托烟台、昆山、眉山三大生产基地，搭建了完善的产能保障体系，可高效响应核心客户批量供货需求，产业链配套与交付服务优势持续凸显。

市场层面，公司深度绑定国内动力电池、储能电池头部企业，跟随客户产能扩张节奏稳步提升供货份额。同时，公司持续推进全球化布局，搭建海外本地化技术服务体系，适配国际新能源供应链标准，稳步拓展海外市场，持续优化市场结构，为业务长期稳健发展提供支撑。光伏材料领域，公司持续保障叠瓦导电胶稳定供货，满足北美客户合作需求，同时紧跟新工艺迭代趋势，持续优化产品性能，推进光伏封装材料高端化升级，通过定制化服务深化客户合作，稳步提升高端市场份额与产品附加值。

（四）高端装备封装业务提质突破，应用场景持续拓宽

公司深耕工业 MR0、轨道交通、汽车整车制造、新能源驱动电机、人形机器人等高端装备核心应用领域，紧跟各行业技术革新与精益化发展趋势，不断打磨迭代产品技术，稳步深化市场布局与渠道渗透。

报告期内，针对高端装备严苛的工况标准与性能要求，公司重点攻关研发多款专用新材料产品，涵盖 800V 高压电驱适配耐高温导热结构胶、适配高速列车振动工况的抗疲劳密封胶、人形机器人关节模组专用精密粘接结构胶等系列产品。

公司通过持续优化产品配方、升级生产工艺、提升场景适配能力，精准匹配高端装备在绝缘密封、导热散热、抗震防护、精密粘接等核心环节的高标准需求。同时，公司持续深化与轨道交通、新能源汽车、工程机械等领域头部客户的战略

合作，相关产品已逐步应用于新一代智能列车、新能源电驱系统、大型工程机械出口机型等标杆项目，实现批量稳定落地，持续巩固公司在高端装备应用材料领域的细分竞争优势，推动业务稳步扩容。

二、坚持创新驱动与人才强企，持续夯实核心技术竞争力

报告期内，公司深度锚定提质增效、价值创造核心目标，坚定践行人才强企、创新驱动发展核心战略，将人才建设、研发投入、体系升级作为筑牢技术壁垒、提升核心竞争力的关键抓手，持续完善立体化、常态化、长效化科技创新体系，以人才赋能创新、以投入支撑研发、以数智升级提效，推动企业核心技术实力与行业竞争力稳步攀升，为公司高质量发展、高效益回报筑牢核心根基。

人才是创新发展的第一资源，公司持续深耕人才队伍建设，搭建高素质研发人才梯队。报告期内，公司多措并举优化人才引育留用体系，搭建分层分级的系统化人才培养体系，持续优化科研绩效考核与激励机制，充分激活科研人才创新活力，打造了一支专业化、创新型的研发团队。截至报告期末，公司研发团队规模达 180 人，其中包含国家级海外高层次专家 2 人，优质、充足的人才储备，为公司核心技术攻关、重点科研项目落地、新产品迭代研发提供了坚实的人力支撑与智力保障，夯实了企业创新发展的人才底座。

以人才建设为依托，公司持续加大研发资源投入，构建“人才+资金”双轮驱动的创新发展格局。报告期内，公司持续加码科技创新投入，研发费用总额达 3,832.39 万元，同比增长 1.46%。持续稳定增长的研发资金投入，为公司核心技术迭代升级、新产品工艺优化、新技术落地应用提供了充足的资源保障，有效支撑各类科研项目有序推进、技术成果持续沉淀，推动研发创新工作常态化、规范化开展，为企业提质增效、技术赋能产业升级提供了坚实的资金支撑。

为进一步提升研发精细化水平与创新效率，赋能研发工作提质增效，公司加速推进研发体系数智化转型升级。报告期内，公司 ELN 系统及全球科创大数据 AI 平台稳定运行，聚焦研发数据结构化管理、核心技术数据库搭建两大核心，全面规范实验全流程操作标准，系统化沉淀企业核心技术资产与研发经验。数智化研发体系的落地应用，有效破解了传统研发效率偏低、数据碎片化、成果难沉淀等痛点，显著提升研发工作效率与成果质量，为后续精准数据分析、智能建模

研发、定制化技术攻关筑牢数字化根基，推动公司研发模式向数智化、高效化、精准化全面升级。

依托完善的人才体系、充足的研发投入、成熟的数智化研发平台，公司在知识产权布局、行业标准制定、核心技术攻关、创新产品落地等领域实现多点突破，持续提升行业话语权与核心竞争优势。知识产权层面，公司高端电子胶粘剂技术成功入选省级企业经营类专利导航项目，既是对公司电子胶粘剂领域技术积淀的认可，也体现出公司在该细分领域具备扎实的知识产权布局与差异化技术竞争力。行业标准建设层面，公司深度参与行业规则体系构建，成果丰硕：主导 1 项行业标准获工信部立项并进入意见征集阶段，主导 1 项国家标准顺利完成立项答辩，参与研制的 3 项国家标准正式落地实施，依托系列标准建设成果，公司行业认可度持续提升，在细分领域的标准参与度与话语权也得到稳步夯实。

三、布局全球产能，加速出海步伐

报告期内，公司稳步推进全国化产能网络建设与全球化研产销布局，持续完善多点联动、区域互补的产业布局体系。国内层面，以烟台总部为根基，逐步建成覆盖华东、华南、西南、华北的研发及生产基地网络，实现核心产业集群就近配套生产，构建规模化柔性制造体系，适配动态订单需求，保障高效交付与产能稳定释放。2026 年上半年，公司结合行业发展趋势及战略规划，完成募投项目变更，将原四川彭山“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”调整为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，落地深圳龙岗，完善本地化研发配套，进一步优化产业资源配置、提升募集资金使用效率，聚焦半导体高端材料主线布局。国内各基地错位分工、协同联动，兼顾规模化量产与柔性快速调产能力，持续夯实国内供应链底盘。

海外层面，公司稳步搭建全球研产销一体化布局，以东南亚作为海外布局核心枢纽，陆续完成新加坡公司、越南技术研发中心、泰国生产基地等本地化主体布局，构建区域技术服务网络。泰国合资公司工厂于报告期内正式开业，该基地聚焦半导体先进封装电子材料等核心产品的本土化生产，全面承接东南亚区域客户订单，实现海外本地化生产与快速交付。依托“全球化生产、本地化服务”的运营模式，基地将为全球客户提供更高效、优质的技术支持，持续优化跨国协同体系，进一步提升企业供应链稳定性与韧性。

四、优化公司治理机制，夯实高质量发展基础

报告期内，公司立足上市公司规范治理与提质增效发展目标，持续迭代优化内控治理制度体系，完成《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》《投资者关系管理制度》等多项核心制度的修订及新增工作。通过完善董高人员管理、信息披露管控、内控责任追究、投资者关系维护等全维度制度规则，进一步厘清各层级权责边界、规范经营决策流程、强化合规风控体系，全面夯实上市公司规范化运营根基，有效提升公司治理的规范性、透明度与运营质效，以制度化、标准化管理赋能企业经营提质增效、稳健发展。

供应链管理方面，公司聚焦提质增效目标，深化全链条精细化管控。围绕市场需求迭代、库存动态调度、供应链高效履约等关键环节，持续优化供应链计划管理体系，通过精准预判市场需求、科学配置库存结构、全流程追踪履约进度，显著提升库存周转效率与供应链资源配置利用率。同时，健全标准化、体系化供应商管理机制，常态化开展供应商履约管控、质量核查与综合绩效评级，严格落实优胜劣汰的动态筛选机制，持续优化供应商资源结构，构建优质、稳定、高效的供应链合作生态。依托公司国内多基地协同布局及海外基地建设优势，强化全球供应链统筹调度能力，有效对冲原材料价格波动、区域供应链不稳定等外部风险，全面提升供应链抗风险能力与企业经营韧性，保障业务稳步拓展、产品高质高效交付，实现供应链体系平稳高效运转。

数字化体系建设方面，公司以数字化赋能全域提质增效，持续加码信息化、智能化体系建设，围绕研发创新、智能制造、信息安全、财务管控、运营管理等核心业务板块，持续完善全流程数字化支撑平台，全面提升企业精细化管理与智能化运营水平。研发领域，推进研发数据资产化建设，积极落地 AI 技术赋能研发应用，覆盖专利快速检索、配方精准筛选、产品性能预测等关键场景，有效缩短研发周期、提升创新研发精准度与效率。生产制造领域，深化 MES 生产管理系统落地应用，打通生产端人、机、料、法、环全维度数据壁垒，实现生产要素集成化管理、生产流程可视化管控；同步推动 MES 系统与 BIP、BPM 等核心系统深度联动，打通跨部门、跨业务数据链路，破除业务协同壁垒，持续实现生产降本、提质、增效。财务管理领域，启动集团财务共享中心试点建设，聚焦费用管控、

资金管理等核心模块，稳步推进总部及下属子公司财务数字化共享体系搭建，有效提升财务治理规范化水平与整体运营效率。信息安全领域，持续优化网络安全防护体系，深化漏洞扫描、日志分析、零信任安全架构等核心技术应用，全方位筑牢网络与数据安全防线，夯实数字化转型安全根基，为企业全域提质增效、高质量发展提供坚实保障。

五、加强投资者沟通，提升信息披露质量

公司坚持以合规治理为基石，高度重视信息披露与投资者关系管理工作。严格对标《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等法律法规与内部制度规范，始终恪守真实、准确、完整、及时、公平的核心披露原则，报告期内，规范完成 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告等定期报告及各项临时公告等信息披露工作，保障全体投资者平等、及时、精准获取公司经营发展关键信息，持续维护信息披露的规范性、严肃性与资本市场公信力。

报告期内，在严守合规披露底线的基础上，公司持续创新信息传播形式、优化投资者沟通服务，着力搭建全方位、立体化、常态化的投资者沟通体系。针对定期报告财务数据、经营成果及各类重大事项公告，在法定文字公告的基础上，公司通过业绩说明会解读、可视化图文简报等多元化形式，通俗化、直观化拆解核心信息，有效降低投资者信息理解成本，帮助市场清晰、全面地掌握公司经营现状、战略布局与未来发展规划，进一步提升市场认可度与投资者信任感。

同时，公司依托上证 e 互动平台、服务咨询专线、实地调研接待、邮箱等多元渠道，持续深化与投资者的双向良性互动。报告期内，公司积极回应市场咨询，通过上证 e 互动平台完成投资者咨询回复，回复率达 100%。此外，公司常态化开展线上线下投资者交流会、积极参与行业策略研讨会，举办 2025 年度及 2026 年第一季度业绩说明会，参与 2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，持续畅通沟通渠道、拉近与市场距离，稳步构建透明公开、互信共赢的良性资本市场沟通生态。

六、健全投资者回报长效机制，持续提升投资吸引力与公司价值

公司始终秉持长远战略布局与可持续稳健经营理念，结合自身发展实际、财务状况及行业发展特点，持续推行科学化、稳定化、常态化的股东回报规划，搭

建健全可持续的投资者回报体系。目前，《烟台德邦科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》持续有效落地，长效稳定的股东回报机制持续优化完善，为常态化回馈投资者筑牢制度根基。

公司始终以合规履行上市公司责任、维护全体股东长远利益为核心经营使命，主动适配资本市场规范化发展要求，持续完善投资者回报与权益保护体系，携手资本市场各方构建良性发展生态，助力资本市场平稳健康发展。2026 年上半年，公司完成第二期集中竞价股份回购方案全部实施工作。本次股份回购基于公司对自身核心价值的高度认可及对未来长期稳健发展的坚定信心，旨在稳定市场预期、提振投资者信心、健全长效激励约束机制、凝聚核心团队力量，进一步提升企业核心竞争力。本次回购实施周期为 2025 年 4 月 2 日至 2026 年 4 月 1 日，回购实施完成后，公司累计回购股份 991,897 股，占公司总股本 142,240,000 股的 0.6973%；回购成交价格区间为 35.79 元/股至 50.93 元/股，累计支付资金总额 40,012,801.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份专项用于员工持股计划或股权激励，深度绑定核心团队与公司发展利益，为企业长期健康、稳健发展提供坚实保障。

自上市以来，公司坚守稳健分红核心原则，在满足利润分配相关条件的基础上，长期保持较高现金分红比例，每年度归属于上市公司股东净利润的现金分红占比稳定维持在 30%以上。2026 年上半年，公司持续落实常态化分红机制，于 5 月 29 日顺利完成 2025 年度权益分派工作。公司持续推进稳定分红举措，固化半年度分红常态化模式，以高频次、稳节奏的分红机制回馈全体投资者，为股东提供持续、可预期的投资收益，切实保障股东合法权益，稳步提升股东长期投资价值与投资获得感。公司结合目前总体运营情况及财务水平，制定了 2026 年中期利润分配方案，具体方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 789,927 股后的股本 141,450,073 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 14,145,007.30 元（含税）。该方案尚需提交公司股东会审议。

七、其他

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项核心举措均有序落地、稳步推进。后续，公司将持续动态评估方案实施成效，常态化落地推进各项提质增效举措，并严格按照监管要求，及时、合规履行相关信息披露义务。同时，公司将切实肩负起上市公司主体责任，以稳健规范的治理体系夯实经营根基，全力提升经营业绩、优化投资者回报，以实实在在的发展成果回馈广大投资者的信任与支持。

本报告所载行动执行情况仅为阶段性工作总结，仅反映当前阶段推进状态，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺及相关承诺，敬请各位投资者理性研判、注意投资风险。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日